

关于信息技术产品贸易的部长宣言 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/328/2021_2022__E5_85_B3_E4_BA_8E_E4_BF_A1_E6_c36_328919.htm

关于信息技术产品贸易的部长宣言(E-version)

新加坡 1996年12月13日各位部长先生：下面谨代表以下世界贸易组织WTO成员国和正在申请加入世界贸易组织的国家或

独立关税地区作出如下宣言，这些国家和地区已就扩大信息技术产品的世界贸易在新加坡达成一致。这些国家和地区是

：澳大利亚、日本、加拿大、韩国、独立关税区（台湾、澎湖、金门和马祖）、挪威、欧洲联盟、新加坡、香港、瑞士

、冰岛、土耳其、印度尼西亚和美国。鉴于信息技术产品贸易在信息工业的发展和在世界经济迅猛发展中的关键性作用

，与会各方一致认为：应该承认提高生活水平和扩大商品产量这一目标，力图争取获得信息技术产品世界贸易的最大自由

，应该在世界范围内支持信息产业的持续性技术发展并对信息技术对全球经济与福利中积极贡献予以关注。与会各方已同意将以下谈判结果付诸实施，它们涉及1994年关贸总协定

《马拉喀什协议》表格中所含条款附加的关税削减，这些关税削减是在有关附录表格的谈判中达成的。宣言正文如下：

1. 各方的贸易体制应该以提高信息技术产品市场准入机会的方式来发展。

2. 依照这份宣言附件中安排的作法，各方将在1994年关贸总协定框架的范围内消除关税和其他任何形式的税费。

(a) 带有HS标题的本宣言附件附表A中列出的全部分类产品（或可分类产品）；

(b) 本宣言附件附表B中载明的全部产品，无论其是否已包含在附表A中。通过1997年开始

，2000年结束的等额关税削减，承认在扩展后的减税框架实现之前，在有限的情况下，产品覆盖范围的扩大可能是必须的。

3. 部长们对宣言附件附表中列出的涉及面很广泛的产品覆盖表表示满意。他们指示他们各自的官员努力推进在日内瓦举行的以这些作法为基础的多边技术谈判，并指示这些官员在1997年1月31日以前完成这项工作，以便确保最大数量的参加方能将本宣言付诸实施。

4. 部长们邀请世贸组织其他成员国的部长以及正在申请加入世贸组织的国家或独立关税地区的部长向其各自的官员们发出相似的指令，以便他们不仅可以参加上面第3段提到的多边技术谈判，而且可以参与全部的信息技术产品世界贸易的扩大工作。

附件：作法和产品覆盖表
附表A：HS标题表
附表B：产品表格
附件：作法和产品覆盖的范围

世贸组织的任何成员国或者正在申请加入世贸组织的国家和独立关税地区可以参加与下列作法相一致的信息技术产品世界贸易的扩大工作：

1. 参加各方将把本宣言第2段所描述的措施并入1994年关贸总协定所附的表格中。此外，采用其官方进出口货物课税表或其他公布的任何版本的课税表中各参加方自己的关税水平或HS六位数水平，取其中进出口方通常使用的任一种关税水平。参加方中的各非世贸组织成员国将自动实施这些措施，直到它们加入世贸组织为止，并且将这些措施并入其关于货物的世贸组织市场准入表中。

2. 在这方面，尽快并不迟于1997年1月之前各参加方将向其它所有参加方提供一份文件，内容包括：(a) 关于怎样在其在WTO关税削减表格中提供合适的关税待遇的详细情况；(b) 附件B中载明的商品的详细HS标题清单。对以上文件将进行重新审议并在多数一致的基础上通过，这一重新审议过

程将在1997年4月1日前完成。。依据《关税减让规定（修订本）》【Modification and Rectification of Schedules of Tariff Concessions (BISD27S/25)】中1980年3月26日决议的规定，以上任一文件一旦完成这一重新审议过程，就将作为有关参加方的WTO市场准入表的修订本向上提交。（1）由各参加方作为其WTO市场准入表修订本而提议所进行的关税削减将降低并消除有关下列任一信息技术产品的关税和其他税费：(a) 取消如上关税将通过等额的税率下调来实现，由各参加方另外达成一致的除外。除非各参加方另有约定，各方将最迟于1997年7月1日以前降低附表中所列商品的所有关税，而且最迟在1997年7月1日以前使第一次类似的关税下调生效，最迟在1998年1月1日以前使第二次类似的关税下调生效，最迟在1999年1月1日以前使第三次下调生效，每一阶段削减的税率将保留至小数点后第一位。(b) 将于1997年7月1日以前在总协定条款 1 (b) 的范围内取消类似的其它关税和任何形式的收费，在向其他参加方提供的文件（供重新审议用）中另有说明的除外。（2）一参加方提议为实现降低消除信息技术产品关税而进行的对其WTO市场准入表的修订产生如下效果：(a) 对于附件A中所列HS标题的情况，通过在合适的地方按其全国关税水平在其WTO市场准入表中创建子分支的方式进行；(b) 对于附表B中载明的产品的情况，通过向其WTO市场准入表添加附件的方法进行，该附件中包含附表B中所有的产品，并且将按其全国关税水平或者HS六位数水平载明那些产品的详细HS标题。各参加方提议的对其WTO市场准入表的修订一旦生效，他们将迅速修改其全国关税表以反映这一变化。

3. 参加方将在货物贸易理事会（Council on Trade in Goods

) 的主办下定期举行会晤，以重新审议附表中载明的产品覆盖表，并希望在以下方面达成一致：是否应借助技术发展、削减关税的经历或者是对HS术语的修改而对附表进行修订，使之添加追加的产品，并就信息技术产品的非关税壁垒进行谈判。诸如此类的谈判将不会损害WTO协议下的权利和义务。

4. 一旦可行，参加各方应尽快并无论如何在不迟于1997年4月1日之前举行会晤，以重新审查建议被接受的情况，并对由此得出的结论进行评估。如果届时代表信息技术产品世界贸易约90%份额的参与国家和地区表示接受的话，如果他们对达成的框架表示满意的话，各参加方将推行宣言中事前规定的措施。在评估是否推行这些措施的过程中，如果参与国家和地区所代表的份额低于信息技术产品世界贸易的90%，各参加方将考虑参与国家或独立关税地区的参与程度，对他们而言，这代表了他们各自在这些产品的贸易上的潜在的数量。在这次会议上，各参加方将决定是否采用这些标准。

5. 如有必要，参与国家和地区将经常并最迟在1997年9月30日以前举行会晤，以考虑他们中在信息技术产品分类方面存在的分歧。他们将从附件B中载明的产品开始进行谈判。各参加方将在如下共同目标上达成一致：在现存HS术语范围内合适之处对这些产品进行一般分类，并考虑关税合作会议

(Customs Co-operation council ，简称为WCO) 的有关解释和规则；在有关分类方面的分歧仍然存在的任何情况下，各参加方将考虑是否就现存最新的HS术语或关于在HS术语解释方面消除分歧之事向WCO提出联合建议。6. 各参加方必须明确：通过将本宣言作为另一参加方（这一参加方须是WTO成员国，大小不限）的实施结果加以推行，总协定的XX 条款

将宣告WTO成员国直接或间接利益的受损或者丧失，无论该参加方的大小情况是否与总协定的条款相抵触。7．每一参加方将以积极的态度考虑来自其他参加方关于以上承诺的任何要求。这样的谈判将无损于WTO协议下的权利和义务。8．在货物贸易理事会主办下工作的各参加方将把关于这些作法和被允许进行的协商会议的情况通知其他WTO成员国和正在申请加入WTO的国家和独立关税地区，希望能够在本宣言的基础上减轻他们参与扩大信息技术产品贸易进程的困难。9．正如这些作法中使用的一样，术语“参加方（有时译为‘各参加方’或‘参与国家和地区’）”意为最迟在1997年3月1日之前提供第2段所规定的文件的WTO成员国或正在申请加入WTO的国家和独立关税地区。10．本附件将供所有WTO成员国以及任何正在申请加入WTO的国家或独立关税地区讨论表决。如果同意加入，他们将以致函总理事长（Director-General）的方式宣布接受，总理事长将会把接受情况通知全体参加方。本附件含两张附表。附表A中列出HS标题或由此将被涉及的重要部分。附表B中列出将被ITA包含的特定产品，无论其在HS中被分在何种类别。附表A 第一部分 HS96 HS说明 3818 圆盘、圆片或其它类似形式的电子产品专用化学涂料、电子产品专用化合涂料 8469 文字处理器 847011计算器和带计算功能的袖珍数据记录复制显示器、（会计）计算机、自动邮资盖印机，验票机及类似包含计算装置的机器、现金出纳机 847010无外接电源的电子计算器和带计算功能的袖珍数据记录复制显示器 847021其他带打印设备的电子计算器 847029其他 847030其他计算器 847040会计计算机 847050现金出纳机 847090其他 8471 自动数据处理器及其装

置、磁卡或光学阅读机、其它地方未说明或包括的将信息以密码形式转录至载体上的机器以及处理类似信息的机器

847110类似物或自动混合数据处理器 847130便携式数字自动数据处理器，重量少于10千克，至少包括中央处理器，键盘和显示器 847141其他数字自动数据处理器（包含在相同的单元内，至少包含中央处理器、输入输出设备，无论其是否相互连接） 847149以系统形式出现的其他数字自动数据处理器 847150不同于子标题8471 41和8471 49下的数字式处理器（无论其是否与以下型号机器中的一至两种机器处于同一单元中） 847160输入或输出设备，无论其是否同时装有存储器 847170存储器，包括中央存储器、光盘存储器、硬盘驱动器和磁带存储器 847180自动数据处理器的其他部件 847190其他

847290自动对讲机 847321第8470号标题下机器中第8470 10，21，29子标题下电子计算器的零附件 847329第8470号标题下机器中非第8470 10，21，29子标题下电子计算器的零附件 847330第8471标题下机器的零附件 847350同样适于与第8469至8472标题下机器配套使用的零附件 ex850440供自动数据处理器及其套件使用的静态转换装置 ex850450供自动数据处理器及其套件使用的其他电感器和远程通信装置 8517 供有线电话和有线电报使用的电子设备，包括带无绳听筒的有线电话机、供波载式或数字式线路系统使用的远程通信设备；电视电话 851711带无绳听筒的有线电话机 851719其他电话机和电视电话 851721传真机 851722电传打印机 851730电话或电报的转接装置 851750供波载式或数字式系统使用的远程通信设备 851780其他装置，包括电话接口系统 8517908517标题下设备的零件 ex851810频率在300Hz至3，4KHz之间，直径不超

过10mm，高度不超过3mm的供远程通信使用的麦克风
ex851830有线电话听筒 ex851829无包装的频率在300Hz至3
，4KHz之间，直径不超过50mm的供远程通信使用的扬声器
852020录音电话 852311宽度不超过4mm的磁带 852312宽度
在4mm至6，5mm之间的磁带 852313宽度超过6，5mm的磁带
852320磁盘 852390其他 852431复制现象而非复制声音或图象
的供激光阅读系统使用的光盘 ex852439其他：依靠自动数据
处理器能复制代表指令，数据，声音，图象的以机读二进制
形式存储的能被控制或向用户提供交互式操作的装置 852440
复制现象而非复制声音或图象的磁带 852491复制现象而非复
制声音或图象的媒体 ex852499其他：依靠自动数据处理器能
复制代表指令、数据、声音、图象的以机读二进制形式存储
的能被控制或向用户提供交互式操作的装置 ex852510不同于
广播或电视的传输设备 852520带接收装置的传输设备
ex852540数字式静止可视图象摄影机 ex852790供电话、报警或
寻呼使用的便携式接收装置 ex852910与广播电话电信设备配
套使用的天线 ex852990供以下设备使用的零件：不同于广播
和电视的传输设备 带接受装置的传输设备 数字式静止可视图
象摄影机 供电话，报警或寻呼使用的便携式接收装置 853120
包括液晶装置（LCD）或发光二极管（LED）的指示器面板
ex853290子标题8531 20下设备的零件 8532 固定的、可变的或
可调整的（预先设定）的电容器 853210设计用于50/60Hz电路
，具有处理不低于0.5Kvar的反应性能力的固定电容器 853221
钽固定电容器 853222铝电解固定电容器 853223陶瓷绝缘体、
单层固定电容器 853224陶瓷绝缘体、多层固定电容器 853225
纸制或塑胶制绝缘固定电容器 853229其他固定电容器 853230

可变或可调整的（预先设定）的电容器 853290零件 8533 电阻器（包括可变电阻器和电位计），不同于热电阻器 853310碳固定电阻器，人造的或薄膜类* 853321其他供电源处理容量不超过20W使用的固定电容器 553329其他供电源处理容量为20W或20W以上的固定电容器 853331线绕可变电阻器，包括可变电阻器和电位计，供电源处理容量低于20W时使用 853339线绕可变电阻器，包括可变电阻器和电位计，供电源处理容量为20W或20W以上时使用 853340其他可变电阻器，包括可变电阻器和电位计 853390零件 8534 印刷电路 853650电动AC开关，包括光电偶输入输出电路（集成晶体管AC开关 853650电动开关，包括温度保护电动开关，由晶体管和逻辑芯片（芯片集成技术）组成，供电电压不超过1000伏时使用 853650供电流不超过11安培时使用的机械式闪速开关 853669供同轴电缆和印刷电路使用的插头和插座 853690电线和电缆的连接和接触部分 8541 二极管、晶体管和类似的半导体设备，感光性的半导体设备，包括光伏太阳能电池（无论是否被组装进模块或制造进控制面板）、发光二极管和封装压电晶体 854110二极管，不同感光性的或发光二极管 854121晶体管，不同于感光性的晶体管，损耗比率小于1W 854129晶体管，不同于感光性的晶体管，损耗比率为1W或1W以上 854130晶体管、双向击穿二极管和双向三端闸流晶体管，不同于感光性的设备 854140感光性的半导体设备，包括光伏太阳能电池（无论是否被组装进模块或制造进控制面板）；光辐射二极管 854150其他半导体设备 854160封装压电晶体 854190零件 8542 集成电路和微系集 854212带集成电路的板卡（‘智能’卡） 854213金属氧化物半导体（MOS技术） 854214由双极技术获

得的电路 854219其他单片数字电路，包括由双极技术获得的电路和MOS技术（BIMOS技术）的联合 854230其他单片的集成电路 854240混合集成电路 854250电子微系集 854290零件 854381近似插件和卡片 ex854389带翻译或词典功能的电子机器 ex854441其他电导体，电压不超过80V时使用，适于连接头，用于远程通讯 ex854449其他电导体，电压不超过80V时使用，不适于连接头，用于远程通讯 ex854451其他电导体，电压在80V~100V时使用，适于连接头，用于远程通讯 854470光纤电缆 900111静电影印装置，直接将原始形象复制到备份上来的操作（直接处理） 900921其他影印装置，包括光学系统 900990零件与附件 9026 测量或检查流量、水平、压力或其他可变流体或气体的工具或装置（如流计量器、级标准度量器、压力计、热力计）不包括第9014、9015、9028或9032标题下的工具或装置 902610测量或检查液体流量或水平的工具或装置 902620测量或检查压力流量或水平的工具或装置 902680其他第9026标题下测量或检查工具或装置 902690第9026标题下的工具或装置的零、附件 902720套色复制与电泳工具 902730分光计、分光光度计和使用光学放射线的光谱摄制仪（紫外线，可视的，红外线） 902750第9027标题下其他使用光学放射线（紫外线，可视的红外线）的工具和装置 902780第9027标题下的其他工具和装置（不同于标题9027 10下的工具和装置） 902790第9027标题下产品的零附件不同于气体或烟分析装置和切片机 903040专为远程通信设计的检测工具和装置【例如，交叉通话测试器、增益测量工具、失真因素测试器、噪声（电压）测量仪】附表A 第二部分半导体制造和测试设备及其零件 HS 代码说明注解 ex7017 10设计用于进行衍射的

石英反应试管和容器、制造半导体圆片的氧化炉供附表 B 使用 ex8491 89 用于制造半导体的化学气体沉淀设备供附表 B 使用 ex8491 90 用于制造半导体的化学气体沉淀设备的零件供附表 B 使用 ex8421 19 供半导体圆片处理用的脱水机 ex8421 91 供半导体圆片处理用的脱水机的零件 ex8424 89 在电镀处理之前清除半导体封装件上污染物的抛光机器 ex8424 89 蚀刻、剥除、清洁半导体圆片的喷雾装置 ex8424 90 蚀刻、剥涂、清洁半导体圆片的喷雾装置的零件 ex8456 10 通过除去材料、通过激光或其它光线或光速束在半导体圆片制造过程中制造材料的机器 ex8456 91 8456 91 剥涂、清洁半导体圆片的装置在半导体材料上蚀刻图形的装置供附表 B 使用 ex8456 99 为半导体装置上的图形制造或修变屏蔽和网线的集合离子来研磨机 ex8456 99 用激光来切断半导体制品上相邻磁道的激光切割装置供附表 B 使用 ex8464 10 用单晶半导体棒锯为薄片或圆片状或条状的机器供附表 B 使用 ex8464 20 研磨、擦亮、轻拭半导体圆片的机器 ex8464 90 在半导体圆片上记录或刻划的切分机器 ex8466 91 供将单晶半导体棒锯为薄片或圆片或条状的机器使用的零件供附表 B 使用 ex8466 91 记录或划线机器的零件供附表 B 使用 ex8466 91 供研磨、擦亮、轻拭半导体圆片机器使用的零件 ex8466 93。供为半导体装置上的模式制造或修复屏蔽和网线的集合离子来研磨使用的零件 ex8466 93 供用激光束切断半导体制品上相邻磁道的激光切割装置使用的零件供附表 B 使用 ex8466 93 下列机器的零件：通过除去材料，通过激光或其它光线或光束在半导体圆片制造过程中制造材料的机器 ex8466 93 下列机器的零件 剥除、清洁半导体圆片的装置供附表 B 使用 ex8477 93 下列机器的零件在半导体材料上蚀刻模式的装置

ex8477 10半导体组装用的封装装置供附表 B 使用 ex8477 90封装装置的零件供附表 B 使用 ex8477 50传送、处理、储存半导体圆片、圆片盒式磁带、圆片盒子和半导体设备用其他材料的自动化机器供附表 B 使用 ex8479 89生成或拉制单晶半导体柱体的设备 ex8479 89通过在半导体圆片上溅射业进行物理沉淀的设备供附表 B 使用 ex8479 89湿蚀刻、发展、剥除或清洁半导体圆片的设备和平面显示器供附表 B 使用 ex8479 89 模片固定装置、带式自动耦合器、（供半导体组装用的）线式耦合器供附表 B 使用 ex8479 89半导体组装的封装设备供附表 B 使用 ex8479 89半导体圆片用晶膜沉淀机器 ex8479 89弯曲、折叠、拉直半导体引线的机器供附表 B 使用 ex8479 89半导体制造用物理沉淀装置供附表 B 使用 ex8479 89半导体圆片上包装摄影用乳液的脱水装置供附表 B 使用 ex8479 90下列装置的零件：通过在半导体圆片上溅射进行物理沉淀的装置供附表 B 使用 ex8479 90下列装置的零件：模片固定装置、带式自动耦合器、（供半导体组装用的）线式耦合器 供附表 B 使用 ex8479 90下列装置的零件：生成或拉制半导体柱体的装置 ex8479 90下列装置的零件：湿蚀刻、发展、剥除或清洁半导体圆片和平面显示器的设备供附表 B 使用 ex8479 90下列机器的零件：传送、处理、储存半导体圆片、圆片盒式磁带、圆片盒子和半导体设备用其他材料的自动化机器供附表 B 使用 ex8479 90下列机器的零件：半导体组装的封装设备供附表 B 使用 ex8479 90下列机器的零件：半导体圆片用晶膜沉淀机器 ex8479 90下列机器的零件：弯曲、折叠、拉直半导体引线的机器供附表 B 使用 ex8479 90下列装置的零件：半导体制造用物理沉淀装置供附表 B 使用 ex8480 71制造半导体装置用注入、压缩模具

ex8514 10在半导体圆片上制造半导体装置的绝热熔炉和烤箱
ex8514 20在半导体圆片上制造半导体装置用的自感应或绝缘
熔炉和烤箱 ex8514 30快速加热半导体圆片用装置供附表B使用
ex8514 30下列设备的零件：在半导体圆上制造半导体装置的
绝热熔炉和烤箱 ex8514 90快速加热半导体圆片的用装置的零
件供附表B使用 ex8514 90第8514 10至8514 30号标题下熔炉和烤
箱的零件 ex8536 90晶片探测器 供附表 B 使用 ex8543 11掺杂半
导体材料等离子注入器 ex8543 30湿蚀刻、发展、剥除或清洁
半导体圆片和平面显示器的设备供附表 B 使用 ex8543 90下列
机器的零件：湿蚀刻、发展、剥除或清洁半导体圆片的设备
和平面显示器供附表 B 使用 ex8543 90下列机器的零件：掺杂
半导体材料用的等离子注入器 9010 41至9010 49在感光半导体
材料上投影、光刻或蚀刻电路布图的设备和平面显示器
ex9010 90第9010 41至9010 49标题下设备的零附件 ex9011 10立
体镜效果的光学显微镜，与专为处理传送半导体圆片或网线
而设计的装置配套使用 供附表B使用 ex9011 20图形缩微摄影
显微镜，与专为处理传送半导体圆片或网线而设计的装置配
置使用供附表 B 使用 ex9011 90下列装置的零附件：图形缩微
摄影显微镜，与专为处理传送半导体圆片或网线而设计的装
置配套使用供附表 B 使用 ex9012 10电子束显微镜，与专为处
理传送半导体圆片或网线而设计的装置配套使用供附表B使用
ex9012 90下列仪器的零附件：电子束显微镜，与专为处理传
送半导体圆片或网线而设计的装置配套使用供附表 B 使用
ex9017 20一种绘圆设备，该设备用于从涂有抗光剂的基层制
造屏蔽或网线供附表B使用 ex9017 90标题9017 20下设备的零附
件供附表B使用 ex9017 90类似绘图设备的零件供附表B使用

9030 82检测半导体圆片或装置的工具仪器 ex9030 90下列装置的零附件：检测半导体圆片或装置的工具和仪器 ex9030 90 下列装置的零附件：检测半导体圆片或装置的工具和仪器 9031 41用于检查半导体圆片或装置或用于检查制造半导体装置的屏蔽、光罩或网线的光学工具和仪器 ex9031 49测量半导体圆片表面微粒污染的光学工具和仪器 ex9031 90标题9031 41下设备的零附件 ex9031 90标题9031 49下设备的零附件 附表B 本协议将涉及到的具体产品的确定无疑的清单，无论这些产品在HS中被分于何种类别。 载明零件的地方，将依据HS分类系统第十六部分第二条第二款【Notes 2(b)to Section XVI】和第90章【Chapter90】的有关规定，分别加以说明：计算机：具有以下功能的自动数据处理机：1) 存储处理程序和至少是执行这些程序立即所需的数据 2) 根据用户要求自由编程 3) 进行用户限定的数学运算 4) 执行，无人工干预，在执行过程中能根据逻辑判断对执行过程进行修正的执行程序 本协议包含这样的自动数据处理机，无论其是否能在中央处理器的帮助下接收、处理技术信号、电视信号、或其他类似的数字集成式的音频或视频信号。以下机器不包括在本协议中：执行特定功能而非处理数据，或者包含自动数据处理机或与自动数据处理机联合工作的机器，并且该机器在本附表A或B未作另外说明 本协议范围内用作在线技术产品转发器的电子放大器及其零部件 供本协议范围内产品使用的平面显示器（包括LCD、电子发光器、等离子发光器及其它技术产品）及其零部件 网络设备：局域网(LAN)和广域网(WAN)装置，包括那些专门用于或主要用于允许将自动数据处理机及其配件连入网络的产品，用于资源共享，例如，中央处理器

、数据存储装置和输入（出）装置（包括适配器、内置转发器、转换器、集线器、桥线和路由器、将自动数据处理机及其配件物理送入的印刷电路）监视器：带有阴极射线管的点屏距小于0.4mm的显示装置，没有本协议定义的计算机中央处理器的帮助，不能接收处理电视信号或其它类似信号或数字式集成音频或视频信号。因此，本协议不包括电视机（包括高清晰度电视）供自动数据处理机使用的光盘存储单元（包括C D驱动器DVD驱动器），不论是否是既可读又可写的，也不论是否处于其自身的单元中。寻呼报警装置及其零部件绘图仪，无论是HS8417标题下的输入（出）装置或是HS9017标题下的绘图仪器本协议范围内产品使用的印刷电路组件，包括例如符合PCMCIA标准的各种插件这样的供外部连接使用的组件。这样的印刷电路组件包括一个或多个标题8534下的印刷电路，其上集成了一个或多个“主动部件”，集成或未集成“被动部件”。“主动部件”意为：二极管、晶体管 and 类似的半导体装置，无论是否具有感光性，处于标题8541下，以及标题8542下的集成路和微系集。与自动数据处理机配套使用的投影式平面显示器，能显示中央处理器产生的数字信息。个人格式化存储器，包括因此而供自动数据处理机使用的媒体，带或不带可消除媒体，无论是磁化的、光学的或采用其它技术媒体，包括Bernoulli Box、Syquest或Zip驱动器盒式存储单元。供自动数据处理机用的多媒体升级装置及其配件，组装起来用于零售，至少包括：扬声器（或麦克风）使ADP机及其配件能处理音频信号的印刷电路组件（声卡）机顶盒，具有如下交流功能：包含调制解调器的以微处理器为基础的装置，使之能够上因特网，并具有信息

交换的互动功能 信息技术(节选) 《关于信息技术产品贸易的部长宣言》(以下简称为“《宣言》”)是新加坡部长级会议的成果之一。《宣言》要求消除对信息技术产品征收的关税和其它税费。经与会各方达成一致作出承诺,要求各个国家或地区将这一承诺写入其WTO市场准入表中,该准入表中应包括宣言附件中包含的所有产品,但是在关于实施期间的长度问题上允许有一定的灵活性,由此,一些参与国家或地区将有更长时间来实现零税率。总体而言,宣言包括了六类主要产品:计算机、通信设备、半导体、半导体制造设备、软件和科学仪器。《宣言》指出,如果代表信息技术产品世界贸易约90%份额的参加国家或地区同意加入,则将实现零关税。截止至1997年9月30日,有以下WTO成员和正在申请加入WTO的国家或独立关税地区同意加入,总体而言,他们代表了信息技术产品世界贸易约93%的份额。这些国家是:澳大利亚、加拿大、捷克共和国、哥斯达黎加、萨尔瓦多、爱沙尼亚、中国香港、冰岛、印度、印度尼西亚、以色列、韩国、澳门、马来西亚、新西兰、挪威、菲律宾、波兰、罗马尼亚、台湾、澎湖、金门和马祖的独立关税区、新加坡、斯洛伐克共和国、瑞士、泰国、土耳其和美国。作为1997年上半年举行的协商会议的成果之一,与会各方就以下问题达成一致:各参与国家或地区将举行高效率的协商会议并对产品范围进行重新审阅,正如《宣言》附件第3段计划的一样,这些协商会议和重新审阅过程定于1997年下半年开始并持续至1998年,时间进程表安排如下: 1997年10月1日~12月31日:在这一阶段内,由参与各方提交可能削减关税的附加产品的清单。 1998年1月1日~3月31日:在这一阶段内,参与各

方对提交的文件进行协商和分类。 1998年6月31日：在此日期之前，有关方面必须举行会晤，商讨决定是否对宣言的附表 A 或附表 B 进行修订。 1998年9月1日：如果已同意对某一清单进行修订，则在此日期前有关方面必须提交修订后的WTO产品市场准入表。 1998年9月15日：在此日期前，有关方面必须举行会晤，重新审阅并修改提交的WTO市场准入表。 1998年9月30日：在此日期前，有关方面必须结束以上列出的重新审阅和修改过程，并酝酿以后的重新审阅工作的程序。 1999年1月1日：开始实施修订后的WTO市场准入表。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com